

公司代码：605358

公司简称：立昂微



杭州立昂微电子股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	立昂微	605358	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴能云	李志鹏
联系地址	杭州经济技术开发区20号大街199号	杭州经济技术开发区20号大街199号
电话	0571-86597238	0571-86597238
传真	0571-86729010	0571-86729010
电子信箱	wny@li-on.com	lizhipeng@li-on.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务分为三大板块, 分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片。主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片; 6 英寸 SBD (肖特基二极管) 芯片、6 英寸 FRD (快恢复二极管) 芯片、6 英寸 MOSFET (金属氧化层半导体场效晶体管) 芯片、6 英寸 TVS (瞬态抑制二极管) 芯片及 6 英寸 IGBT (绝缘栅双极型晶体管) 芯片; 6 英寸 GaAs (砷化镓) 射频芯片、6 英寸 VCSEL (垂直共振腔表面发射激光器) 芯片等三大类。三大业务板块产品应用领域广泛, 包括 5G 通信、汽车电子、光伏产业、消费电子、低轨卫星、智能电网、医疗电子、人工智能、智能驾驶、物联网、机器人、光通信等终端应用领域。经过二十多年的发展, 公司已经成长为目前国内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台, 形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研发和产业化, 以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件芯片业务带动化合物半导体射频芯片产业的经营模式, 很好地兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜力, 为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

(1) 半导体硅片业务

报告期内, 虽然半导体硅片市场下滑, 但公司依托技术突破及市场拓展实现逆势增长。公司 12 英寸硅片已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路, 以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件。产品结构持续优化, 大尺寸硅片出货量快速增长, 高附加值产品增加明显。公司继续发挥重掺外延片的技术优势, 6-8 英寸外延片出货量占据国内市场前茅。公司半导体硅片业务拥有众多境内外知名客户, 其中 12 英寸硅片已经进入中芯国际、华虹半导体、重庆润西微电子、芯联集成、合肥晶合、粤芯半导体、上海积塔、士兰微、青岛芯恩、重庆万国、北京燕东、格科半导体、杭州富芯、浙江创芯、上海集成电路研发中心、Onsemi、Tower、日本东芝等客户的供应链。

报告期内, 公司半导体硅片实现主营营业收入 223,850.45 万元 (含对立昂微母公司的销售 33,295.69 万元), 相比上年同期增长 24.91%。从销售数量来看, 折合 6 英寸的销量为 1,512.78 万片 (含对立昂微母公司的销售 222.73 万片), 较上年同期增长 53.68%, 其中 12 英寸硅片销售 110.30 万片 (折合 6 英寸为 441.19 万片), 较上年同期增长 121.23%。

(2) 半导体功率器件芯片业务

报告期内, 公司充分发挥自身产业链一体化的优势, 以不断的技术创新与稳固的技术合作充分满足客户的多样化需求, 进一步丰富产品系列、优化产品结构、拓展优质客户, 围绕光伏与车规两大产品门类, 优先扩大沟槽产品销售规模及占比, 稳定提升 FRD 产品的产销占比, 加快 IGBT 等产品的开发, 从而确保了全年功率器件芯片业务产销量再创历史新高。产品结构中, 光伏控制用芯片中高附加值沟槽 SBD 占比超 50%, 电源管理用芯片同比增长 51%, FRD 芯片销量增长超 20%, 并作为一级供应商进入 H 公司供应链。车规级芯片已批量供应国内外知名汽车厂商, 在公司半导体功率器件芯片营收占比进一步提升。功率器件芯片业务主要客户有: H 公司、比亚迪、台湾半导体、宏微科技、杭州道铭、南通皋鑫等。

报告期内, 公司半导体功率器件芯片实现主营营业收入 86,245.27 万元, 相比上年同期下降 16.20%。从销售数量来看, 销量为 182.40 万片, 较上年同期增长 6.30%。

(3) 化合物半导体射频芯片业务

射频芯片业务和技术已进入全球第一梯队, 射频芯片产品进入低轨卫星终端客户并实现大规

模出货；开发了二维可寻址 VCSEL 工艺技术，成为行业内首家量产二维可寻址激光雷达 VCSEL 芯片的制造厂商。受益于产品技术实现完全突破，射频芯片已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，国产替代加速；多规格、小批量、多用途、高附加值的特殊用途产品持续放量。在客户总量、订单数、产能利用率、出货量、销售额等方面均有大幅度增长，毛利率大幅转正。产品覆盖昂瑞微、唯捷创芯、慧智微、康希通信、瑞识科技、锐石创芯、禾赛科技、速腾聚创、老鹰半导体等头部客户，并成功导入手机、汽车等终端供应链。

报告期内，公司化合物半导体射频芯片实现主营业务收入 29,541.78 万元，相比上年同期增长 115.08%。从销售数量来看，销量为 4 万片，较上年同期增长 123.04%。

2024 年全球经济呈现“弱复苏、高波动、强分化”特征。亚太新兴市场依托制造业复苏保持中高速增长，欧美发达经济体受高利率与能源转型阵痛制约增速放缓。叠加地缘政治冲突及产业链重构加速，全球半导体市场面临复杂变局。在此环境下，公司经营也迎来多重挑战：需求变化导致产品价格承压，扩产转产推高固定成本，叠加可转债利息及存货跌价计提，利润空间持续收窄。面对严峻形势，在公司董事会领导下，全员攻坚克难，推动产能、技术、市场与良率实现显著提升，发展态势持续向好。

报告期内，公司实现营业收入 309,231.66 万元，较上年同期增长 14.97%，创出历史新高；剔除利息、折旧摊销等因素的影响后，EBITDA（息税折旧摊销前利润）为 63,669.83 万元，较上年同期下降 26.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,575.71 万元，较上年同期下降 504.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,595.86 万元。

影响 2024 年度公司业绩下降的主要因素有：

（1）产能扩张带来的成本压力。随着 2023 年扩产项目陆续转产，本报告期折旧摊销支出 93,907.26 万元，较上年同期增加 20,760.50 万元，给公司带来了较大的成本压力；

（2）产品降价导致毛利率大幅下降。为了适应行业周期波动，同时大力拓展市场份额，公司主要产品售价相比 2023 年下降明显，叠加固定成本增加的影响，导致综合毛利率由 2023 年度的 19.76% 下降至 2024 年度的 8.74%，减少了 11.02 个百分点，毛利总额同比减少 26,097.75 万元。

（3）公允价值变动损失导致利润减少。2024 年度公司持有的上市公司股票股价变动产生公允价值变动损失 2,056.81 万元（上年同期为公允价值变动收益 1,822.72 万元）。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 81,096.60 万元，与上年同期的 102,679.73 万元相比，减少 21,583.13 万元，降幅 21.02%，主要系本期质押用于开具银行承兑汇票支付材料采购款的定期存款增加所致；投资活动产生的现金净流出 210,773.48 万元，与上年同期的 186,068.49 万元相比，增加 24,704.99 万元，增幅 13.28%，主要系本期购建固定资产支付的现金相比上年同期增加所致；筹资活动产生的现金净流入 110,790.59 万元，较上年同期增加 178,316.93 万元（上年同期为净流出 67,526.34 万元），主要系公司本期银行长期借款增加所致。

报告期末，公司总资产 1,932,283.05 万元，较期初增长 5.73%；总负债 1,098,906.70 万元，较期初增长 25.87%；归属于上市公司股东的净资产 733,773.09 万元，较期初下降 7.96%。

报告期内，公司开展的经营工作主要情况如下：

（1）产品矩阵迭代升级，出货营收双双突破历史峰值

公司秉持长期主义发展理念，坚持与国家战略同频共振，依托全产业链优势，凭借敏锐的市

场洞察力、完善的产品矩阵、深厚的技术积淀、多元化的工艺平台以及规模化生产能力，把握电子信息行业复苏及 AI、机器人、低空经济等新兴应用场景机遇，聚焦车载、工控、消费电子领域需求，深化 BCD、CIS、超低阻半导体硅片、FRD 芯片、IGBT 芯片、VCSEL 芯片、pHEMT 芯片等高附加值产品布局，通过产品创新驱动营收与出货量创历史新高。

在半导体硅片领域，公司成功开发出高压 IGBT 器件用低氧高阻硅抛光片、超结 MOSFET 器件用硅外延片、低压 MOSFET 器件用超低电阻率硅抛光片和硅外延片等 8 英寸及 12 英寸产品，并顺利导入 Vishay（威世）、台湾富鼎、重庆芯联、深圳润鹏等十余家海内外头部客户，加速拓展工业控制、汽车电子及消费电子等应用市场。市场需求持续增长的同时，有力促进了相关产品的技术创新迭代。

在功率器件芯片领域，基于自主研发的 600-1200V FRD 芯片量产技术及高压沟槽肖特基二极管芯片设计技术，公司成功推出车规级系列产品，实现从技术突破到规模化量产的重要跨越。产品凭借超低功耗和卓越性能，在消费电子、工业控制、光伏逆变器及汽车电子四大领域实现快速渗透。特别是在新能源汽车市场，通过与行业领军企业的战略合作，公司产品的市场竞争力和品牌价值获得显著提升。随着汽车产业电动化、智能化转型加速，汽车电子业务已成为公司未来增长的关键引擎。

在化合物半导体射频芯片领域，公司聚焦 5G 通信、智能驾驶、机器人、低空经济产业，在二维可寻址大功率激光器技术上取得重大突破，构建了从核心器件研发到终端应用的全链条技术体系。通过持续深化产学研协同创新机制，公司关键技术攻关取得系列突破，与战略客户联合开发的产品已进入稳定放量期，为公司在 5G 通信、智能驾驶、机器人、低空经济等黄金赛道建立差异化竞争优势提供了坚实支撑。

（2）高强度研发显成效，三大板块同步实现里程碑突破

技术创新作为企业发展的战略引擎，是构建市场竞争壁垒的核心要素。公司始终以市场需求为导向，依托技术创新平台实施精准攻关，通过突破关键工艺、加速高附加值产品研发，持续强化核心技术储备。2024 年，公司研发投入达 2.9 亿元，同比增长 4%，占营业收入比例 9.39%。研发团队规模持续扩大，截至 2024 年末技术研发人员增至 563 人，较 2023 年净增 29 人，占员工总数的比例为 16.14%，其中硕士及以上学历占比 32%。依托持续的研发投入与技术积累，公司稳步拓宽产品矩阵，深化下游行业应用，推进产品迭代升级。

在半导体硅片领域，成功开发 14 类具有差异化应用场景的新产品，具体包括：12 英寸新产品 93 款，进入量产的有 72 款；8 英寸新产品 95 款，进入量产的有 68 款；6 英寸新产品 118 款，进入量产的有 106 款。12 英寸新品销售额占同尺寸产品营收 76%，8 英寸新品销售额占同尺寸产品营收 32%，6 英寸新品销售额占同尺寸产品营收 20%。公司攻克逻辑芯片及存储芯片用 12 英寸硅片制造技术，突破 12 英寸 P 型轻掺单晶、12 英寸闪存用单晶工艺和动态内存用单晶工艺，同步推进 8 英寸重掺砷低阻产品及 8 英寸重掺磷超低阻单晶工艺升级，产品已进入客户送样验证阶段。

在功率器件芯片领域，聚焦高频化、高压化趋势，为 H 公司等多家战略客户开发高频低损耗、高可靠性 FRD 芯片系列产品，在新能源汽车与工业控制领域加速国产替代，自主研发的代工平台获得产业链主流厂商认可，为工业通信设备及电源管理芯片的自主可控提供支撑。

在化合物半导体射频芯片领域，2D VCSEL 产品凭借高精度、低功耗及车规级可靠性优势，切

入智能驾驶与机器人核心供应链，应用于车载激光雷达等场景；pHEMT 产品以全频段覆盖、超低噪声及高频功率特性，突破 5G 毫米波与卫星通信关键技术瓶颈。

截至 2024 年末，公司累计获得 85 项授权专利（其中 38 项发明专利），进一步夯实技术壁垒，巩固行业领先地位。

（3）射频技术强势突围，卡位低轨卫星和人工智能终端新蓝海

化合物半导体射频芯片业务在 2024 年实现战略转型升级：技术全面突破并加速下游应用落地，产能利用率显著提升带动月出货量持续增长，同时把握国际国内市场需求变化，成功切入低轨卫星、低空经济、机器人、智能驾驶及光通信等新兴领域供应链。公司构建了覆盖射频芯片与激光器芯片的量产代工平台，形成基站射频前端、卫星通信收发芯片、车载激光雷达等全场景产品矩阵。GaN 射频器件凭借高功率密度特性助力客户设备小型化与能效升级，满足 5G 基站 Massive MIMO 及低轨卫星终端等前沿需求。

在国内率先基于双异质结技术开发出首款 InGaP DHBT 工艺，其功率附加效率（PAE）与抗失配（Ruggedness）性能达到国际先进水平。HBT 工艺技术已量产 9 种差异化方案，其中 LH05 工艺以高线性特性适配基站/WiFi 场景，LH07 工艺以高健壮性服务卫星通信，LH09 工艺集成高增益与高线性优势，全面覆盖现有及下一代通信系统需求。全球首发支持功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）及开关（SW）的 0.15 μm E/D-mode GaAs pHEMT 多功能工艺，同时突破二维可寻址大功率 VCSEL 工艺技术，成为全球首家量产车规级激光雷达 VCSEL 芯片的制造商，产品已应用于智能驾驶与机器人领域。宇航级射频芯片实现低轨卫星终端规模化交付。

公司开发的国内第一款 6 英寸 0.45 微米的碳化硅基氮化镓（GaN HEMT）工艺技术取得重要进展，技术指标对标或超过竞品，6 英寸 0.25 微米的 GaN HEMT 工艺技术也在加紧开发中。

立昂东芯以高频高功率技术为核心驱动力，依托全产业链掌控能力和国产化先发优势，通过持续研发迭代实现工艺节点突破，公司成长为国内先进代工厂，打破海外厂商垄断格局，确立国产替代领军地位。

（4）大客户战略实施成效显著，三大业务协同发展助力营收增长

2024 年，立昂微以技术引领、产能保障、服务优化为三大支点深化大客户战略，推动三大业务板块协同突破。通过构建“半导体硅片+功率器件芯片+射频芯片”全产业链闭环，实现从材料到终端产品的深度整合，客户结构持续优化，战略客户合作深度与广度显著提升。在车载领域形成金瑞泓定制硅片、立昂微车规器件芯片、立昂东芯激光雷达芯片的一站式解决方案，显著缩短客户产品开发周期并提升供应链效率。

半导体硅片业务实现 12 英寸轻掺硅片规模化量产，良率与品质对标国际水平，成功导入中芯国际、华虹半导体等头部厂商供应链，12 英寸硅片销量同比激增 121.23%，在逻辑/存储芯片领域市场份额持续扩大。功率器件芯片业务聚焦新能源与光伏赛道，市场份额稳居国内市场前茅，车规级 FRD、IGBT 产品通过比亚迪等车企认证并稳定放量。射频芯片业务突破 5G 基站、卫星通信、智能手机核心技术，面向中兴等通信设备龙头，助推 5G 基站射频国产化率突破 60%；智能手机端三维异构集成芯片进入 H 公司的供应链，带动射频芯片营收同比增长 115.08%。射频芯片业务合作模式升级至联合研发与产能共建，在 5G 通信、新能源汽车等战略领域形成深度绑定，持续巩固行业领军地位。

（5）持续改进质量管理体系，不断提高质量保证能力

公司以质量创新为核心战略，依托半导体全产业链协同优势，构建卓越绩效管理、全流程质量追溯及数字化实验室系统，实现产品良率与可靠性指标行业领先。在原材料管控、生产工艺优化、检测验证等环节实施全链路精细化管理，为严格质控提供资源保障。通过建立供应商协同管理系统，有效整合供应链资源，推动供应商技术交流与能力升级，确保原材料品质稳定可靠。

严苛质控体系助力公司实现客户审核 100%通过率，成功切入多家新的头部企业供应链，荣获华润微、浙江创芯、南通皋鑫颁发的“优秀供应商”奖，瑞能半导体、道铭微颁发的“最佳供应商”奖，吉顺芯微的“最佳交付奖”、扬杰科技的“潜力协作伙伴”奖、士兰微的“战略合作供应商”奖等，赢得市场高度认可，持续巩固行业领军地位。

(6) 产能规模持续扩大，为未来发展蓄力

2024 年公司通过产能扩张形成战略储备，以产能蓄水池效应承接未来市场需求，构建市场壁垒。截至报告期末，半导体硅片产能包括 6 英寸抛光片（含衬底片）60 万片/月、8 英寸抛光片（含衬底片）57 万片/月、12 英寸抛光片（含衬底片）30 万片/月，6-8 英寸外延片 82 万片/月、12 英寸外延片 10 万片/月；功率器件芯片月产能达 23.5 万片（产品涵盖 6 英寸 SBD、FRD、MOS、TVS、IGBT）；射频芯片年产能 15 万片（产品涵盖 6 英寸 InGaP HBT、GaAs pHEMT、BiHEMT、VCSEL 及碳化硅基氮化镓）。

(7) 强化成本控制，提升运营效率

2024 年，面对原材料波动与市场竞争加剧的双重压力，公司深化“向管理要效益”战略，全面推进降本增效与成本控制体系建设，取得显著成效。生产端推行精益管理架构革新，硅片事业部通过推行精益生产管理建立标准化作业体系、新设成本管理部细化成本模型，关键工序效率提升明显。供应链端发挥集中采购优势，通过国产替代、战略合作、竞价机制等组合策略，大幅降低原辅料采购成本，持续推行供应商库存管理模式，有效减少原材料资金占用。能源管理方面，通过设备运行参数优化、循环系统升级及屋顶光伏发电、废水处理装置改进等，实现综合能耗大幅降低，形成质量与成本的双重竞争优势。

(8) 深化战略布局，推动发展新韧性

积极响应国家战略部署，深度融入产业发展大局，以“国之大者”的使命担当，主动承接集成电路材料领域链主企业任务。作为牵头单位组建浙江省先进半导体材料创新联合体，通过供应链协同、联合技术攻关等模式，强化产业链上下游协作，持续提升资源整合效能与产业聚合能力，有力推动半导体设备及材料国产化进程。2024 年，公司以终端用户身份参与上游材料厂商赛迈科实施的等静压石墨研发项目，并加入由拓烯科技牵头的晶圆载具关键材料创新联合体的研发工作。

立昂东芯与浙江金瑞泓分别取得高新技术企业认定，浙江金瑞泓和立昂微成功入选浙江省制造业单项冠军培育企业，其中立昂微光伏用肖特基二极管产品由浙江省经信厅推荐申报国家制造业单项冠军。此外，公司斩获杭州市数字经济百强、ESG 公益示范企业等多项荣誉，浙江金瑞泓入选宁波市制造业百强企业名单，立昂东芯获评杭州市钱塘区“雨燕企业”称号。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	1,932,283.05	1,827,599.25	5.73	1,854,162.38
归属于上市公司股东的净资产	733,773.09	797,235.30	-7.96	820,453.57
营业收入	309,231.66	268,966.99	14.97	291,421.63
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	306,341.82	266,785.20	14.83	287,536.70
归属于上市公司股东的净利润	-26,575.71	6,575.25	-504.18	68,778.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-26,595.86	-10,552.44	不适用	55,653.97
经营活动产生的现 金流量净额	81,096.60	102,679.73	-21.02	119,454.25
加权平均净资产收 益率(%)	-3.44	0.82	减少4.26个百分点	8.91
基本每股收益(元 /股)	-0.39	0.10	-490.00	1.02
稀释每股收益(元 /股)	-0.39	0.10	-490.00	1.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	67,906.44	77,979.70	81,768.55	81,576.97
归属于上市公司股东的净利润	-6,315.14	-370.50	1,251.44	-21,141.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-4,936.15	777.01	558.59	-22,995.31
经营活动产生的现金流 量净额	36,196.42	16,992.31	10,945.96	16,961.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

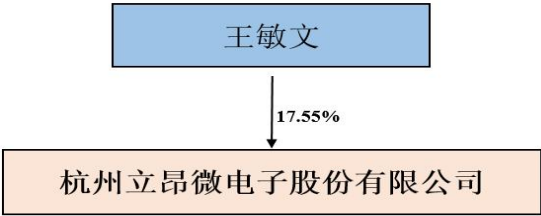
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						74,852	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						73,351	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王敏文		117,831,266	17.55		质押	67,000,000	境内 自然 人
宁波泓祥和创业投资 合伙企业（有限合伙）		39,958,224	5.95		无		其他
宁波利时信息科技有 限公司	-2,005,655	29,364,200	4.37		质押	27,345,000	境内 非国 有法 人
国投创业投资管理有 限公司—国投高新 （深圳）创业投资基 金（有限合伙）	-3,000	20,166,527	3.00		无		其他
宁波泓万企业管理合 伙企业（有限合伙）		12,267,878	1.83		无		其他
王式跃		9,763,286	1.45		无		境内 自然 人
香港中央结算有限公 司	-5,189,405	9,534,125	1.42		无		境外 法人
韦中总	-139,100	8,638,571	1.29		无		境内 自然 人
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金	4,494,952	7,500,121	1.12		无		其他

徐国强	-437, 900	6, 769, 205	1. 01		无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人王敏文持有泓祥投资 78. 50%出资份额，持有泓万投资 55. 16%出资份额，为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

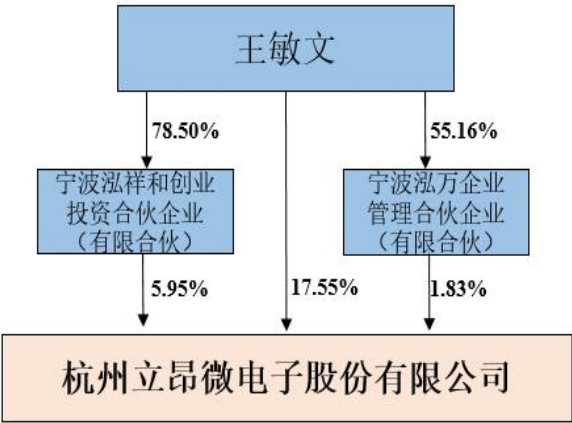
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 309,231.66 万元，较上年同期增长 14.97%；剔除利息、折旧摊销等因素的影响后，EBITDA（息税折旧摊销前利润）为 63,669.83 万元，较上年同期下降 26.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,575.71 万元，较上年同期下降 504.18%。经营业绩下降的原因主要有：产能扩张带来的成本压力；为了适应行业周期波动，同时大力拓展市场份额，公司主要产品降价导致毛利率大幅下降；公允价值变动损失导致利润减少。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用

(本页无正文，为杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要之签字页)

法定代表人：王敏文

杭州立昂微电子股份有限公司（盖章）

2024 年 4 月 28 日